



DSPIC33FJ128MC506A-H/PT

Număr parc	DSPIC33FJ128MC506A-H/PT	Statutul RoHS	N/A
Producator / Marca	Micrel / Microchip Technology	Starea stocului	8107 pcs stock
Descriere produs	IC MCU 16BIT 128KB FLASH 64TQFP	Barca din	Hong Kong
Foi de date	16-bit Embedded Control Solutions.pdf 16-bit Embedded Control Solutions.pdf DSPIC33FJzzzMCX06/8/10A.pdf	Calea de transport	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

8107 pcs stock

Preț de referință (în dolari SUA)

160 pcs

\$4.29

Obțineți o ofertă

Vă rugăm să faceți clic pe „Obțineți o ofertă” și completați toate câmpurile necesare. Vom răspunde la solicitarea dvs. în termen de 24 de ore prin e-mail. Dacă întâmpinați probleme, vă rugăm să lăsați un mesaj sau să ne trimiteți un e-mail la info@global-ic.hk și ne vom reveni cât mai curând posibil.

OBȚINEȚI O OFERTĂ

Specificații de DSPIC33FJ128MC506A-H/PT

Tensiune - alimentare (Vcc / Vdd)	3V ~ 3.6V	Pachetul dispozitivului furnizor	64-TQFP (10x10)
Viteză	20 MIPS	Serie	Automotive, AEC-Q100, dsPIC™ 33F
Dimensiunea RAM	8K x 8	Tip memorie program	FLASH
Dimensiunea memoriei programului	128KB (128K x 8)	Periferice	Brown-out Detect/Reset, DMA, Motor Control PWM, POR, PWM, QEI, WDT
Pachet / Caz	64-TQFP	Pachet	Tray
Tip oscilator	Internal	Temperatura de Operare	-40°C ~ 150°C (TA)
Numărul de intrări / ieșiri	53	Tipul de montare	Surface Mount
Dimensiunea EEPROM	-	Convertoare de date	A/D 16x10b/12b
Core dimensiune	16-Bit	Procesor Core	dsPIC
Conectivitate	CANbus, I ² C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART	Numărul produsului de bază	DSPIC33FJ128MC506

Vești înrudite



Terran Orbital extinde producția, sprijinind șapte autobuze prin satelit

2023/09/13

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu FuturePunct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în Future Future Industrial Network Infra

2023/09/18

EUMW: Rohde și Schwarz îmbunătățește testerea radar auto auto

2023/09/15

Toshiba adaugă MOSFET cu patru pini pentru a reduce pierderile

2023/08/31

Conținut sponsorizat: semiconductori de ultimă oră

2023/09/15

Senzorul actual al automobilului este de 1% pe viață și include MCU

2023/09/12

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu FuturePunct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în Future Future Industrial Network Infra

2023/08/29

Embedded World: Video Interviu - Longsys on R&D, Design și Vânzări de stocare

2023/03/27

Modulul direcționat cu fir pentru vehicule personalizate și cu volum redus

2023/09/13

Sisteme modulare - Diavolul este în detaliu încorporat

2023/04/5

Viewpoint: detectarea focurilor de foc ultra-timpuriu cu senzori IoT folosind LoRaWAN

2023/07/14

Conținut sponsorizat: Trecerea la succes: Convergența OT și IT cu FuturePunct de vedere: Dumprea firelor pentru a vărsa kilogramele în Future Future Industrial Network Infra

2023/07/4